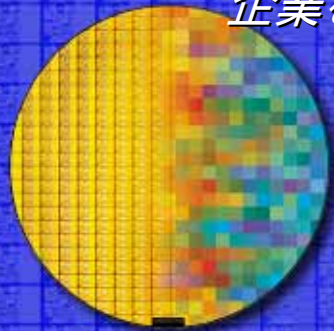


Grid技術2005年 サービス指向エンタープライズ: 企業を変革する技術



池井 満
HPC担当部長
インテル株式会社



企業・業態の変革を加速しているのは 技術収束 (Convergence)

- 協業(社内外)の改善
- 生産性の向上
- 地球全体にわたる広範囲の業務分散や移動性の実現

自律的
計算環境

コンバージド
ネットワーク

無線と移動性

サービス指向エンタープライズ

様々な技術の登場がサービス指向エンタープライズを不可欠に



2



サービス指向エンタープライズ 特長

- 様々な種類の機器を横断的に利用可能
- 無線端末(RFID?)からデータセンタのバックエンドまで
- ウェブ・サービスをベースに

統合:

- 業務過程とワークフロー
- アプリケーション
- 計算、通信とストレージ機器
- データと情報のアクセスと統合化
- 新規端末や最新技術
- 動画、音声とデータ

統合:

- 部品等の供給元
- 協業企業
- サービス・プロバイダ
- アウトソース先
- 顧客

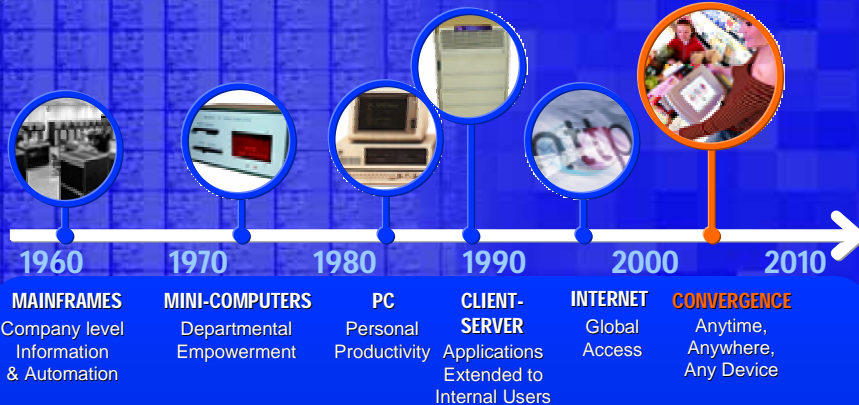


3



次世代への移行には サービス指向エンタープライズが必要

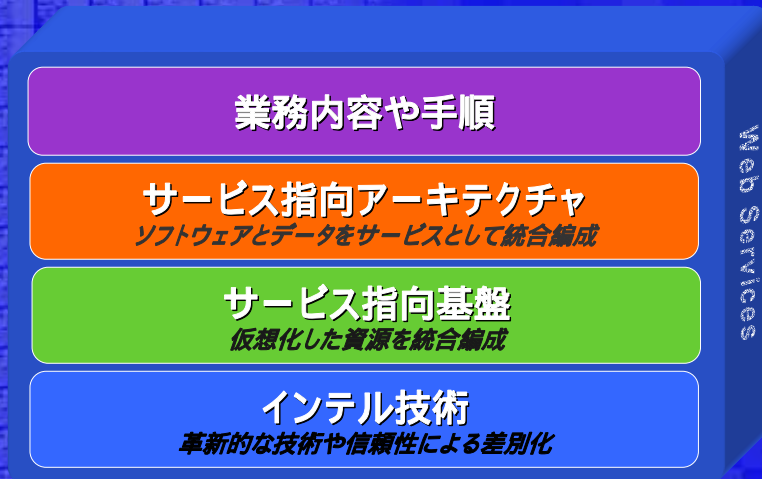
SERVICE ORIENTED
ENTERPRISE



4



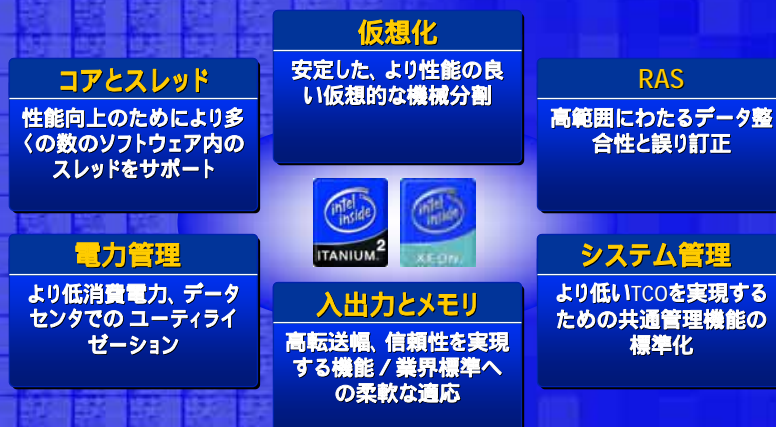
サービス指向エンタープライズ 構成層



5



インテルのエンタープライズ向技術の展望 現在から将来へのビジネスに必要な機能や性能を提供



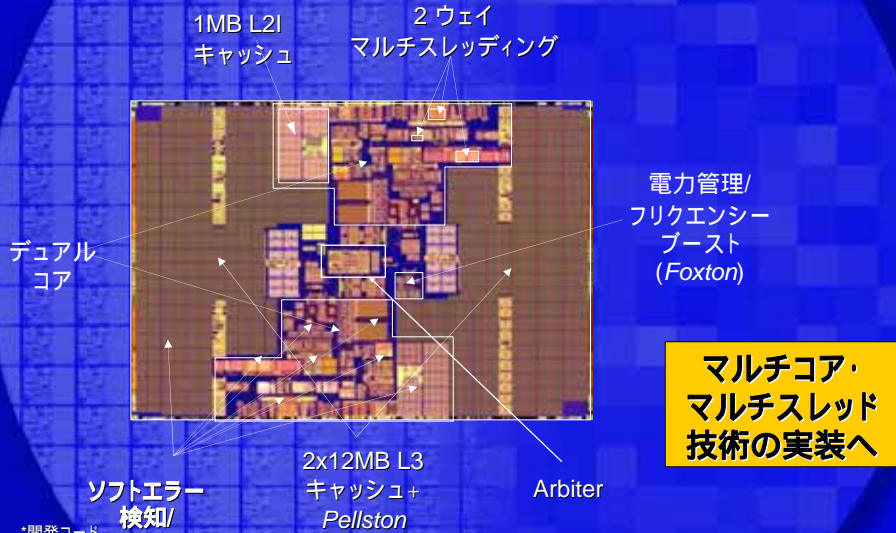
Intel によるサーバ技術の発展

Comparisons referenced are in relation to Intel product offerings today (as of May 2004).

6



デュアルコアMontecito*概要



インテル製品は、予告なく仕様変更される場合があります。資料に記載されているすべての製品、日付、および価格情報は、現在の予想に基づくものであり、計画以外の目的ではご利用になれません。



Backup



インテル® サーバ・プラットフォームのロードマップ

マルチプロセッサ (MP) プラットフォーム

インテル® Itanium® 2 プロセッサ MP搭載プラットフォーム
Itanium® 2-6M/Itanium® 2-9M
Intel® E8870/Enabled

次世代 MP
Montecito/Montvale
Intel® E8870/Enabled

共通プラットフォーム・アーキテクチャ
Tukwila
将来のチップセット

インテル® Xeon™ プロセッサ MP搭載プラットフォーム
Xeon™ Processor MP
Enabled chip sets

次世代 MP
Cranford/Potomac/Tulsa
Intel® Twin Castle/Enabled

共通プラットフォーム・アーキテクチャ
Whitefield
将来のチップセット

デュアルプロセッサ (DP) プラットフォーム

インテル® Itanium® 2 プロセッサ DPおよびLV
プラットフォーム
Itanium® 2 (+LV)/Fanwood (+LV)
Intel® E8870/Enabled

次世代 DP/LV
Millington (+LV)/
DP Montvale (+LV)
Intel® E8870/Enabled

将来のプラットフォーム
Dimona (+LV)
将来のチップセット

インテル® Xeon™ プロセッサ搭載プラットフォーム
Xeon™ プロセッサ/Irwindale (2005)
Intel® E7520 および Intel E7320

次世代 DP
次世代チップセット

将来のDP
将来のチップセット

- EPIC アーキテクチャ
- 改良型のMCA
- PCI Express
- DDR-2
- Intel® EM64T
- 電力管理 (DBS)
- ハイパー・スレッディング・テクノロジー
- IPMI 2.0

- デュアルコア
- マルチスレッディング
- Foxton, Pellston テクノロジー
- 電力管理 (Pconfig/PSMI)
- Silverdale Technology
- フルバツアのDIMM
- マネージャビリティ: フル・リダイレクト (KVM, IDE-R), WS マネージャビリティ

- マルチコア
- 改良型仮想化
- 改良型I/Oおよびメモリ
- 改良型RAS
- 共通プラットフォーム・アーキテクチャ
- マネージャビリティ: 自律型の割当・保守・復旧

現在のプラットフォーム



2005-2006年以降



将来



本製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。本資料に記載されているすべての製品、日付、および数値は、現在の予想に基づくものであり、計画以外の目的ではご利用になれません。

